
2025年12月期 第1四半期 決算説明会

2025年5月12日（月）



証券CODE:4971

<https://www.mec-co.com/>

1 売上： 4,423百万円（前年同期比 1.6%増）
営業利益： 1,093百万円（前年同期比 3.8%増）

2 為替の影響は前年同期比
売上： 32百万円増、営業利益： 12百万円増

3 薬品売上： 4,237百万円（前年同期比 8.0%増）
出荷量： 10,247ton（前年同期比 4.0%増）

4 主要製品売上は前年同期比
CZ 9.0%増、 V-Bond 4.6%増、 EXE 2.8%増、 SF 46.8%減

(単位：円)

	期初想定	2025Q1	2024Q1	2024Q4
N T D	4.76	4.63	4.71	4.72
R M B	21.08	20.99	20.55	21.04
H K D	19.48	19.66	18.90	19.41
T H B	4.22	4.51	4.16	4.31
E U R	164.84	160.71	160.89	163.79
U S D	152.33	152.93	147.86	151.44

- 海外現地法人は、基本的に現地通貨建てでの取引であり、連結会計で円換算する際に、円／現地通貨レートの影響を受ける。
- いずれも、期中平均レートを採用。
- 当社の主要外国通貨は、台湾ドル（NTD）、中国人民元（RMB）。
- 各通貨に対して想定レートから0.1円変動する場合の影響額は次のとおり。
 NTD：（売上）18百万円（営業利益）12百万円
 RMB：（売上）6百万円（営業利益）3百万円

*いずれも、当期Q1実績

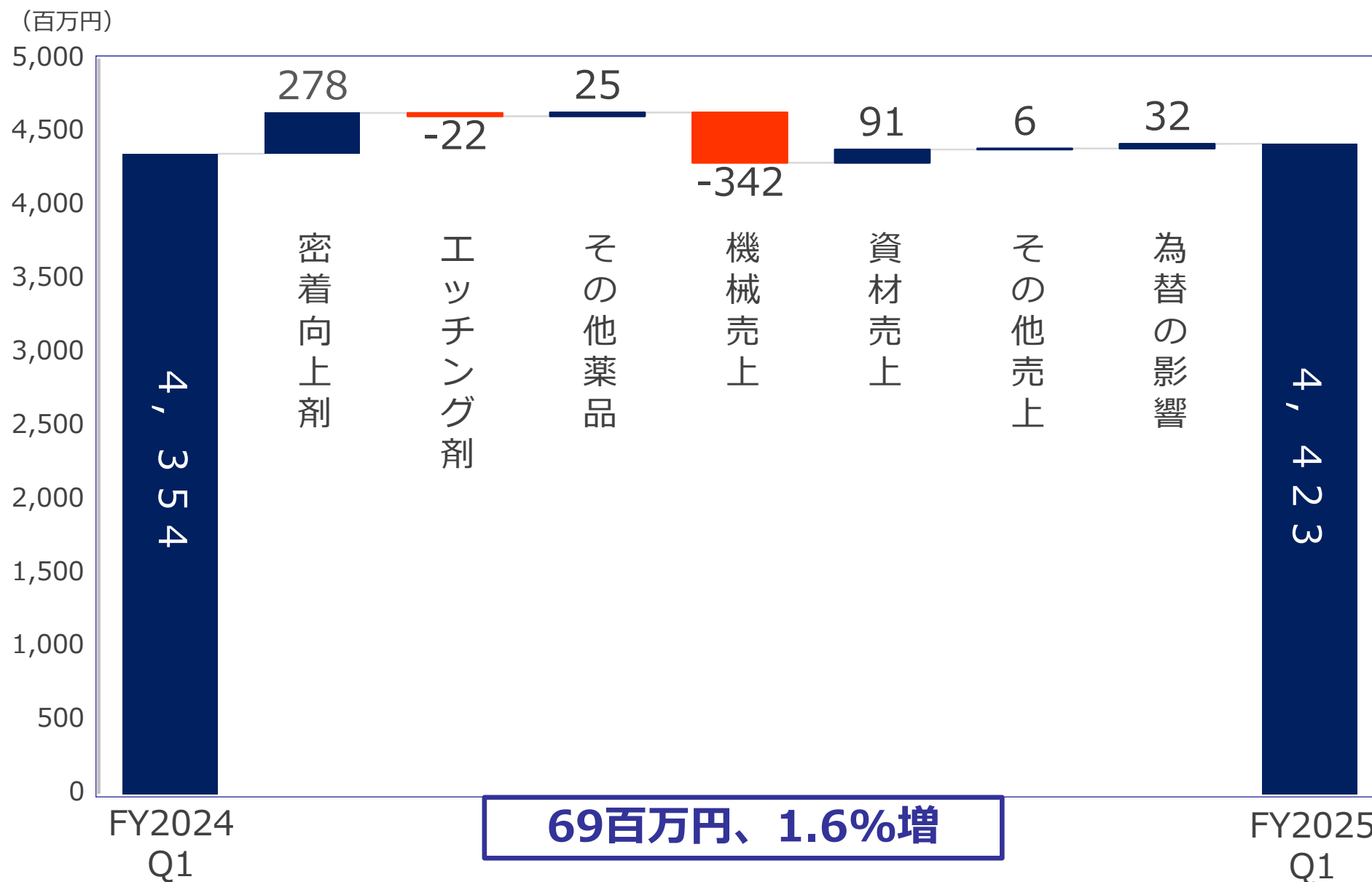
2025年12月期 第1四半期 業績概要



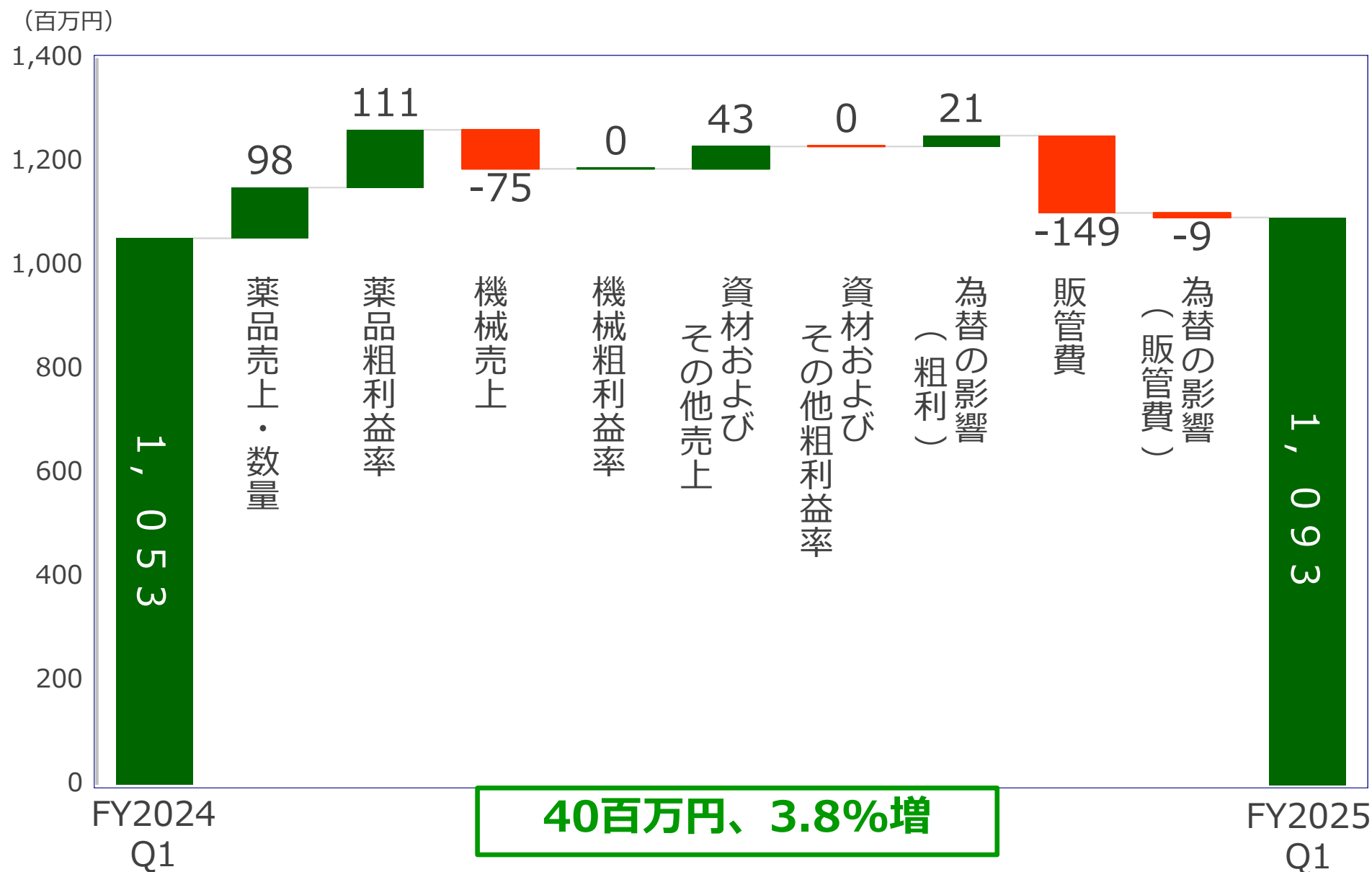
(単位：百万円)

	第1四半期						通期		
	FY24.12 Q1		FY25.12 Q1				FY24.12	FY25.12	
	(実績)	進捗率	(実績)	進捗率	前年同期比		(実績)	(予想)	前期比
売上高	4,354	23.9%	4,423	22.1%	69	1.6%	18,234	20,000	9.7%
薬品売上高	3,924	-	4,237	-	313	8.0%	17,478	-	-
売上総利益	2,549	-	2,748	-	199	7.8%	11,101	-	-
売上総利益率	58.5%	-	62.1%	-	-	-	60.9%	-	-
販売費及び一般管理費	1,496	-	1,655	-	159	10.6%	6,539	-	-
売上高比率	34.4%	-	37.4%	-	-	-	35.9%	-	-
営業利益	1,053	23.1%	1,093	21.9%	40	3.8%	4,562	5,000	9.6%
営業利益率	24.2%	-	24.7%	-	-	-	25.0%	-	-
経常利益	1,132	24.2%	1,059	20.8%	△73	△6.5%	4,682	5,100	8.9%
経常利益率	26.0%	-	24.0%	-	-	-	25.7%	-	-
税引前当期利益	1,128	-	1,057	-	△70	△6.3%	4,669	-	-
当期純利益	779	34.0%	476	13.2%	△302	△38.9%	2,291	3,600	57.1%
EBITDA	1,320	-	1,252	-	△68	△5.2%	5,487	-	-
1株当たり当期利益 (円)	41.62	-	25.44	-	-	-	122.38	192.26	-
1株当たり配当金 (円)	-	-	-	-	-	-	45.00	55.00	-
ROE	3.1%	-	1.8%	-	-	-	8.9%	12.8%	-

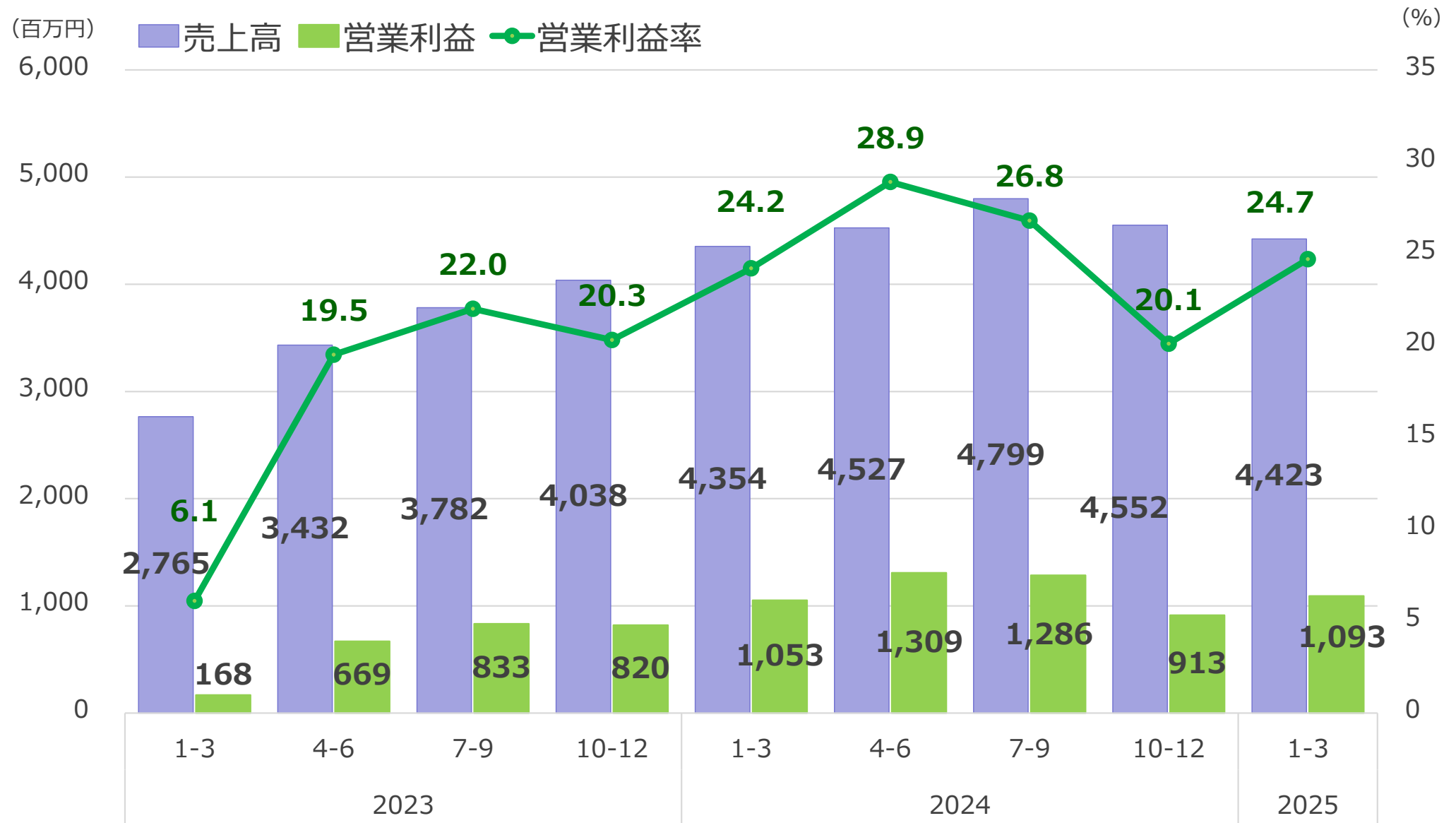
連結売上高前年同期比分析



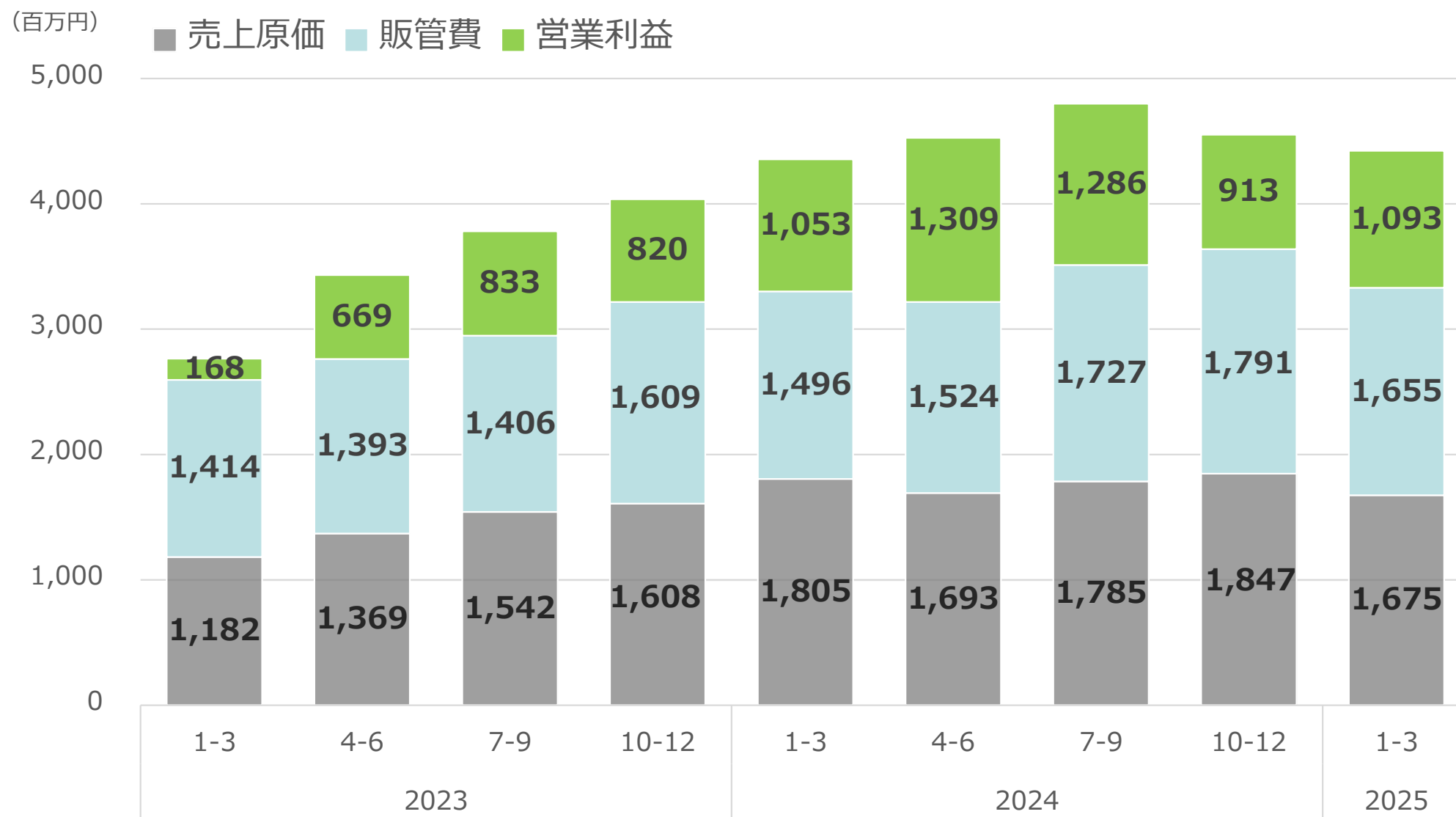
連結営業利益前年同期比分析



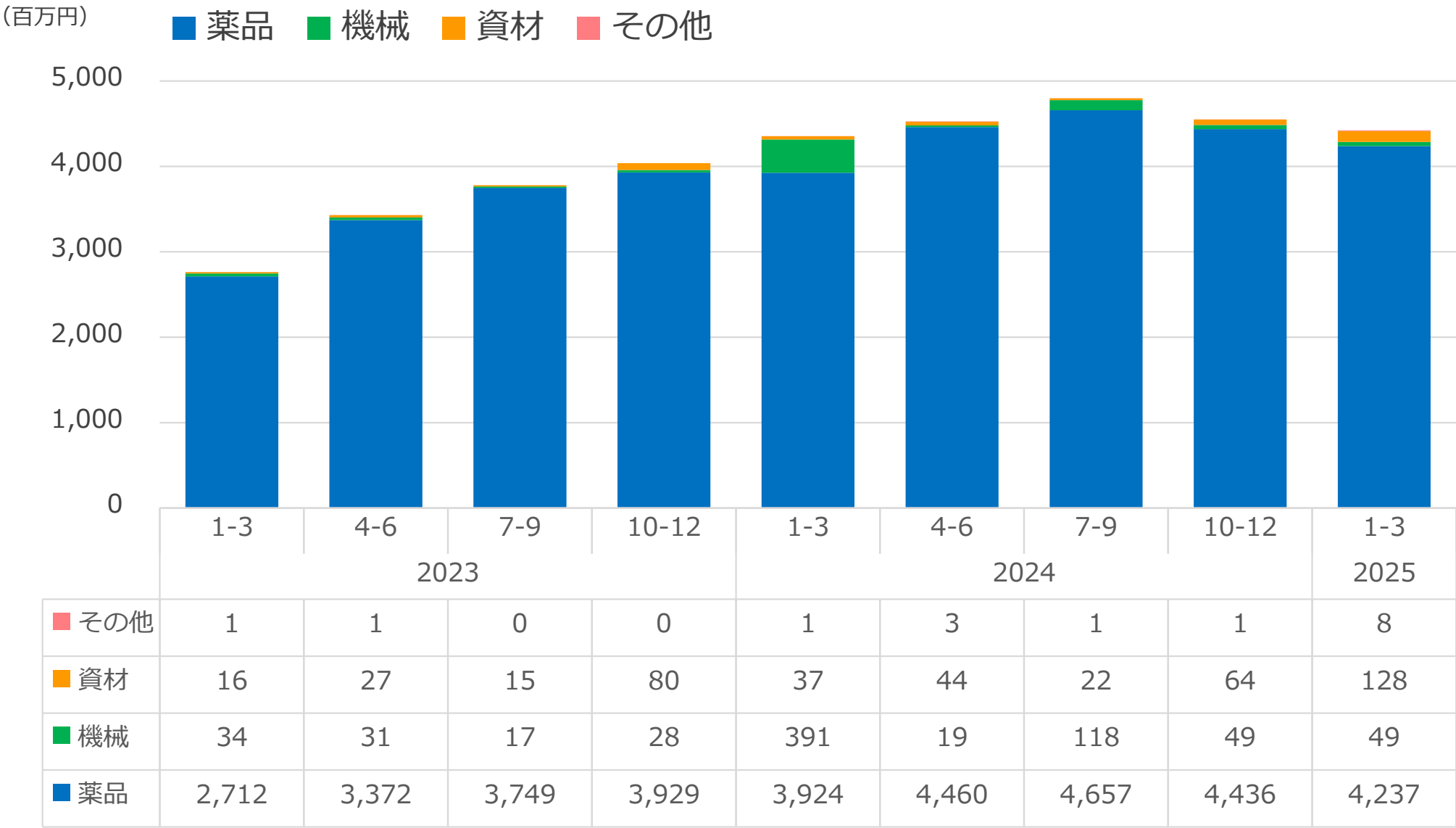
連結売上高と営業利益/営業利益率



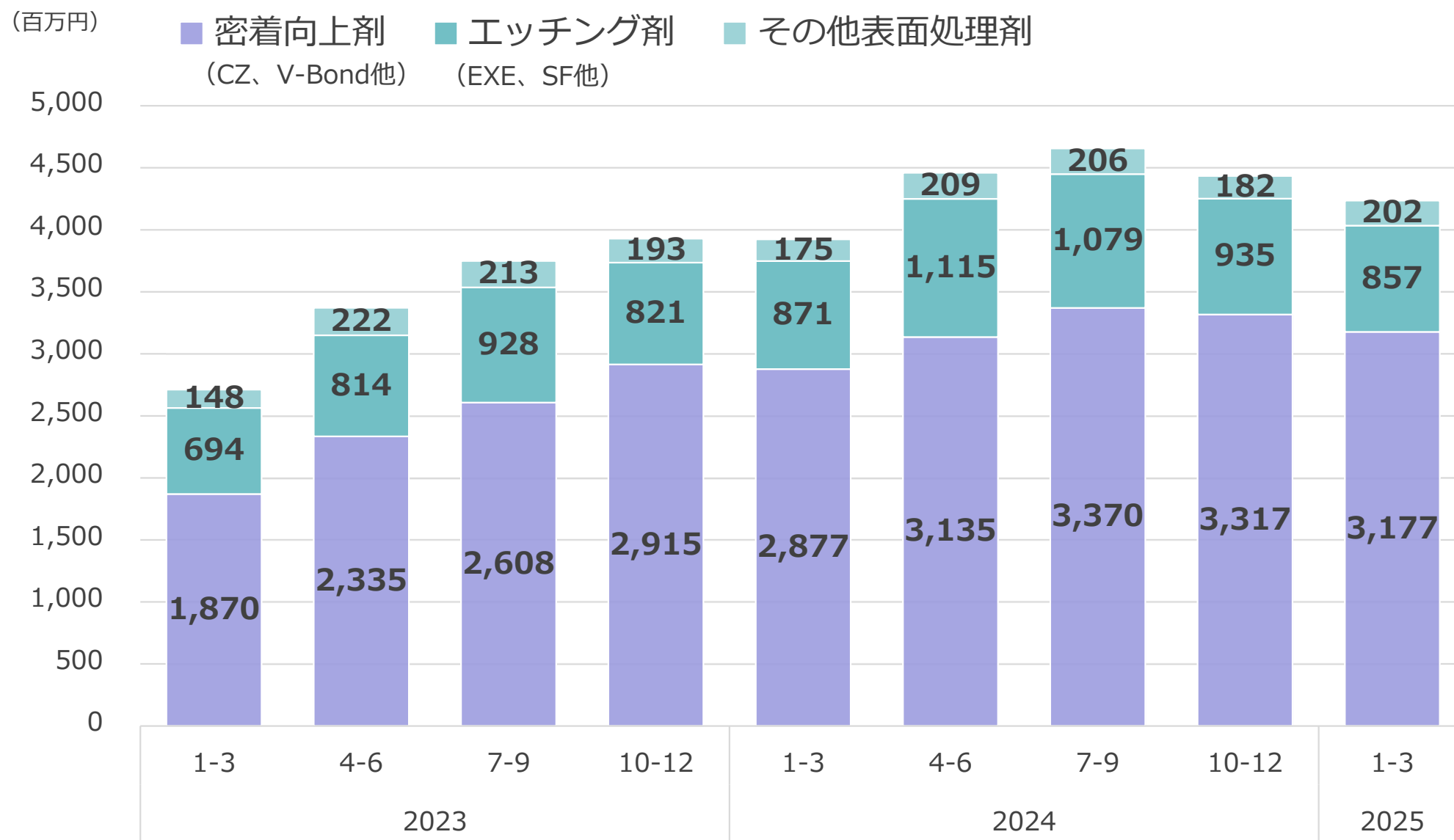
連結損益構造



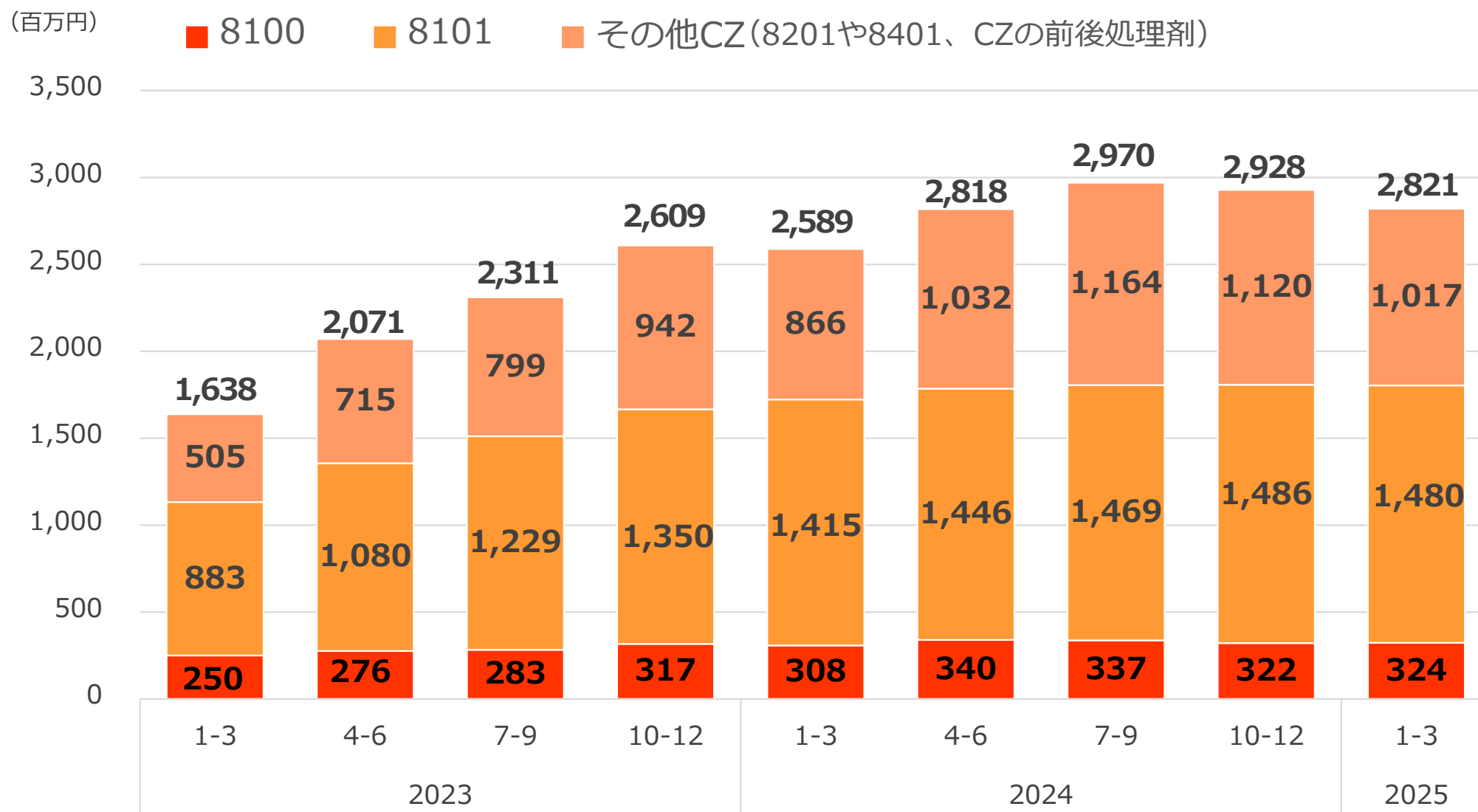
連結品種別売上高



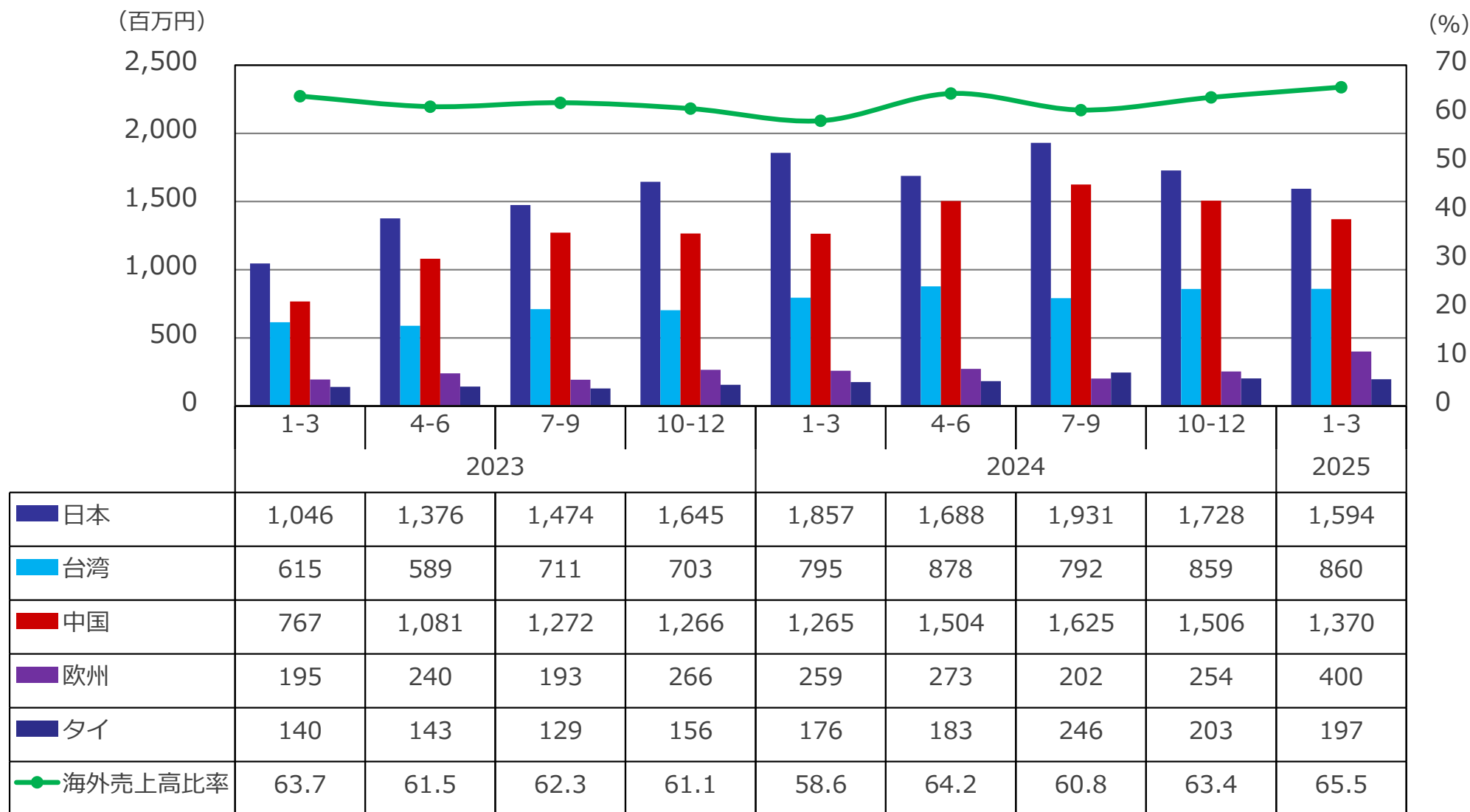
連結薬品別売上高



CZシリーズ売上高



地域セグメント別売上高



・ 日本国内代理店経由で販売した海外顧客への売上を海外売上高比率に含めた場合の比率80.4%
(前年同一期間は、73.1%)。

今後の見通し

事業環境

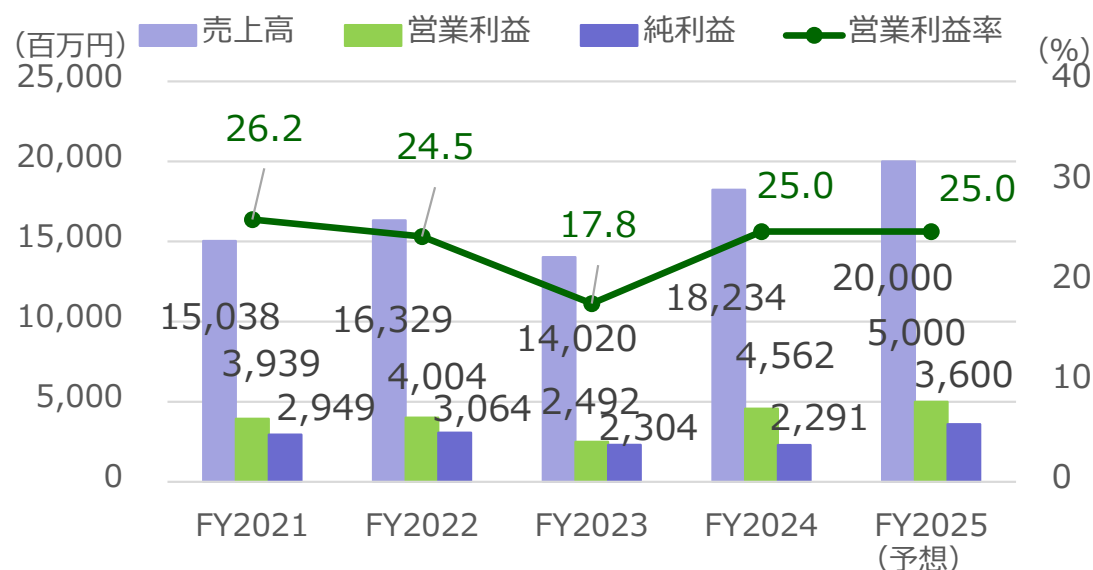
- ・短期的には、回復基調にある半導体市況の影響を見込む。
- ・中長期的には、IoTやAI、5G/6G、クルマの電動化・自動化・コネクテッド化やDX・GXの進展等、デジタル革命の進展に伴い技術革新が進む。技術の広がりを背景に、当社関連市場が拡大する。
- ・特に高まる半導体需要によるPKG基板の増加、超高密度化や超高周波化により関連する「CZシリーズ」、「化学密着向上剤」需要の伸びを見込む。

主要製品

- CZ : 短期的には半導体市況回復の影響を受ける。
中長期的にはPKG基板の増加、大型・高多層化等により需要拡大。
- V-Bond : 短期的にはクルマ、スマートフォンは回復基調。
衛星通信基板向け増加基調。
- EXE : 短期的にはディスプレイは堅調。継続性は不透明。
- SF : タブレットPC需要の影響を受ける。

2025年12月期 連結業績予想

	FY2024		FY2025					
	Full-year		1 H			Full-year		
	百万円	利益率 (%)	百万円	利益率 (%)	増減率	百万円	利益率 (%)	増減率
売上高	18,234	-	9,600	-	8.1%	20,000	-	9.7%
営業利益	4,562	25.0	2,250	23.4	△4.8%	5,000	25.0	9.6%
経常利益	4,682	25.7	2,300	24.0	△12.9%	5,100	25.5	8.9%
純利益	2,291	12.6	1,450	15.1	△23.3%	3,600	18.0	57.1%
1株当たり 純利益 (円)	122.38	-	77.44	-	-	192.26	-	-

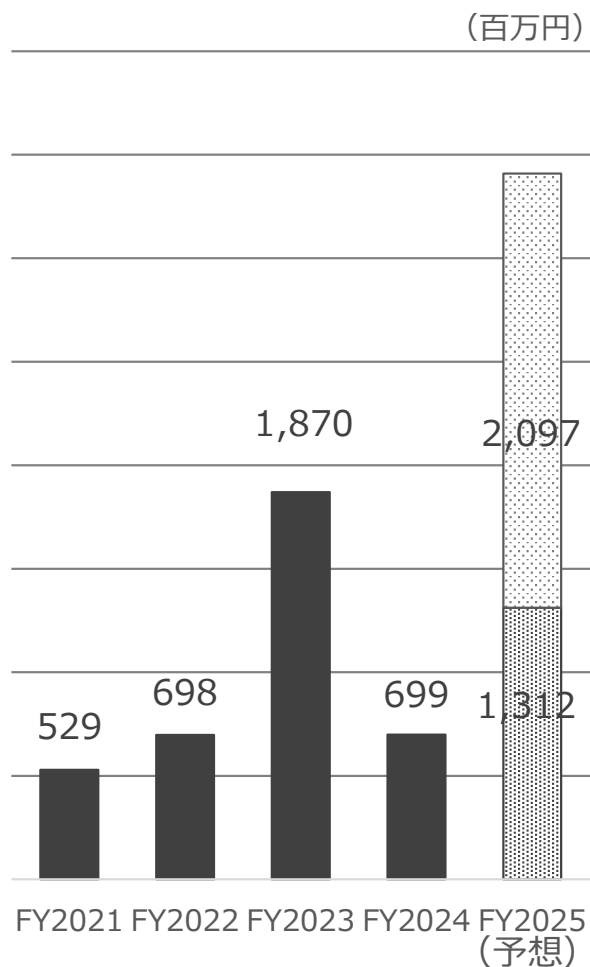


為替レート

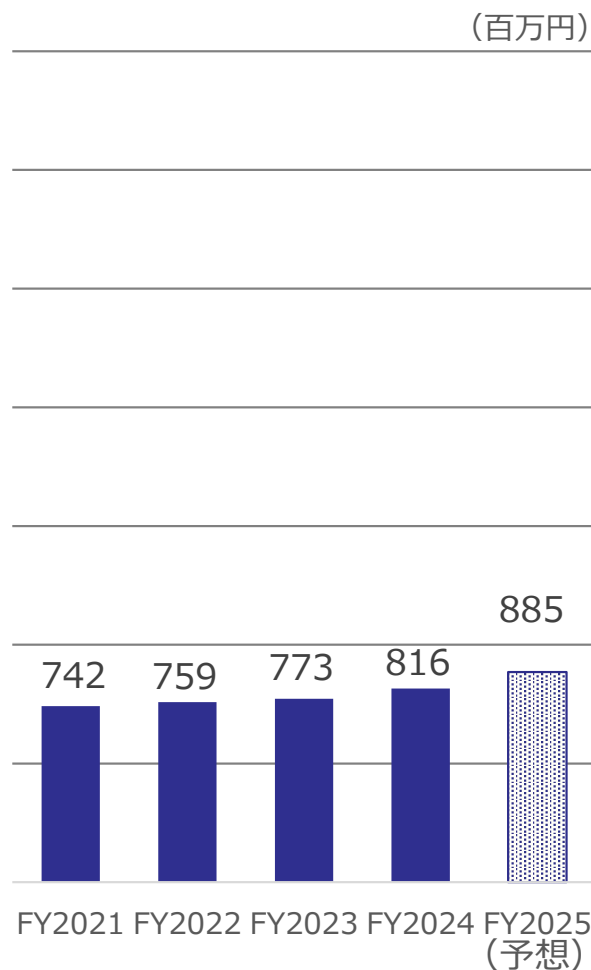
	FY2024	FY2025
N T D	4.72	4.76
R M B	21.04	21.08
H K D	19.41	19.48
T H B	4.31	4.22
E U R	163.79	164.84
U S D	151.44	152.33

設備投資額と減価償却費、研究開発費

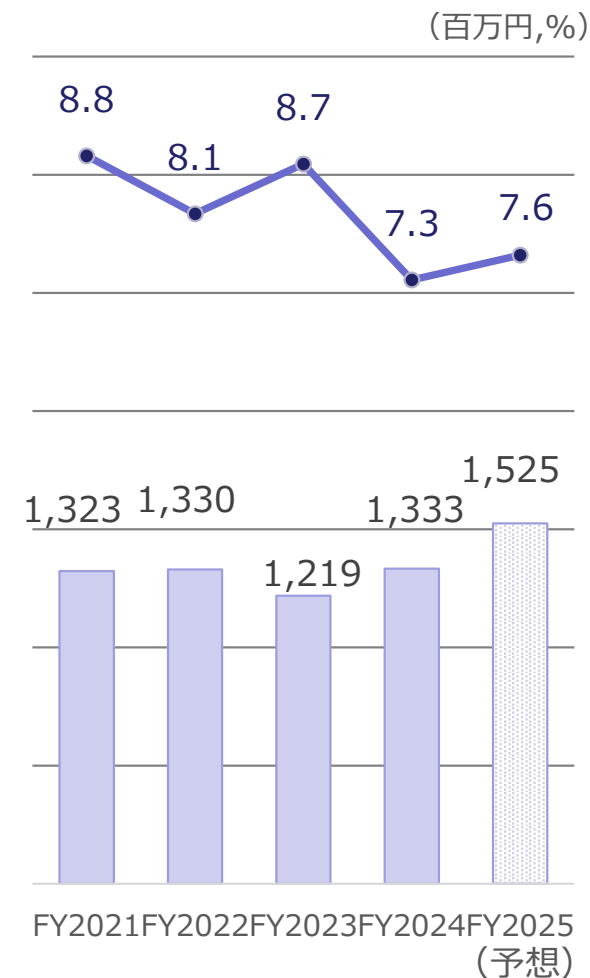
設備投資額



減価償却費

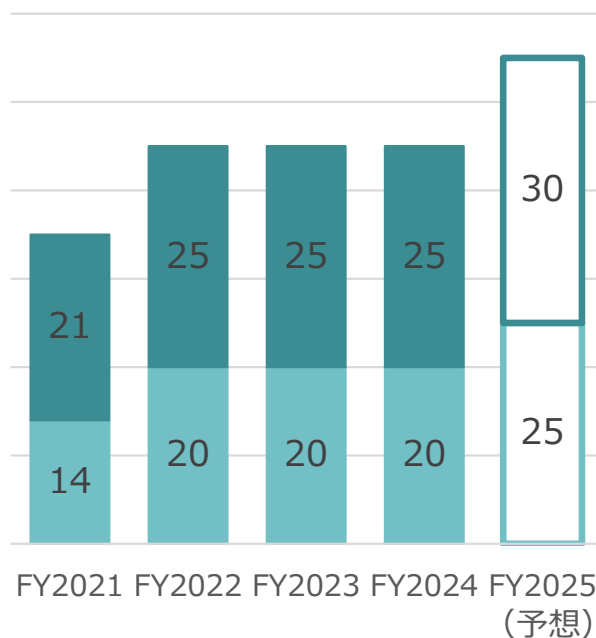


研究開発費と 売上高研究開発費比率

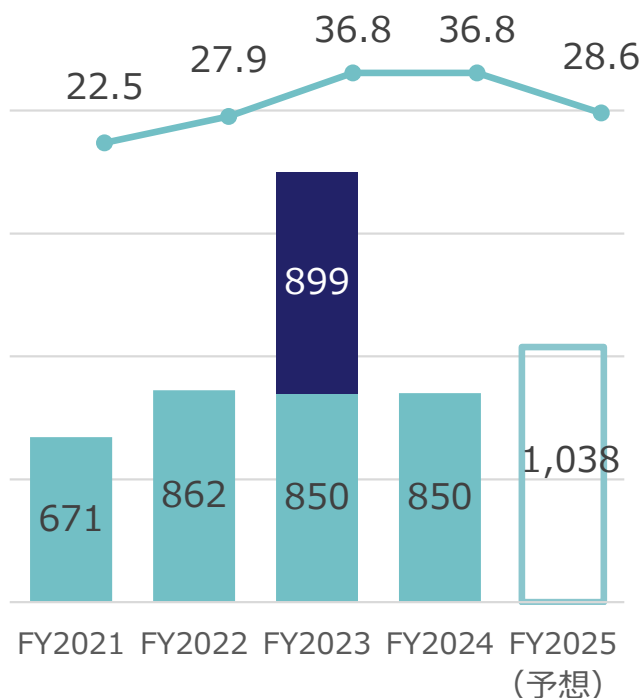


配当金と連結配当性向、ROEの推移

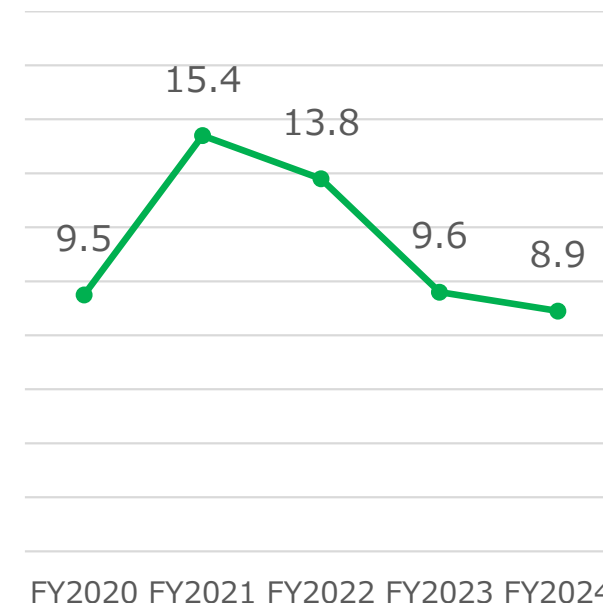
1株当たり配当金



配当総額/自己株式取得額/連結配当性向



ROE



■ □ 中間 (円) ■ □ 期末 (円)

■ □ 配当総額 (百万円) ■ 自社株式取得額 (百万円)

● 連結配当性向 (%)

● ROE (%)

■ 2030年ビジョン中期経営計画Phase2 (2025~2027年) において

【株主還元方針】 1株当たり年間配当金の維持・成長

連結配当性向 30%目標

自己株式取得は状況に応じ機動的に実施

【ROE目標】 10%以上

Environment

- 環境負荷低減製品の開発
- 適正な化学物質管理
- 資源循環の推進
- 気候関連問題への対応

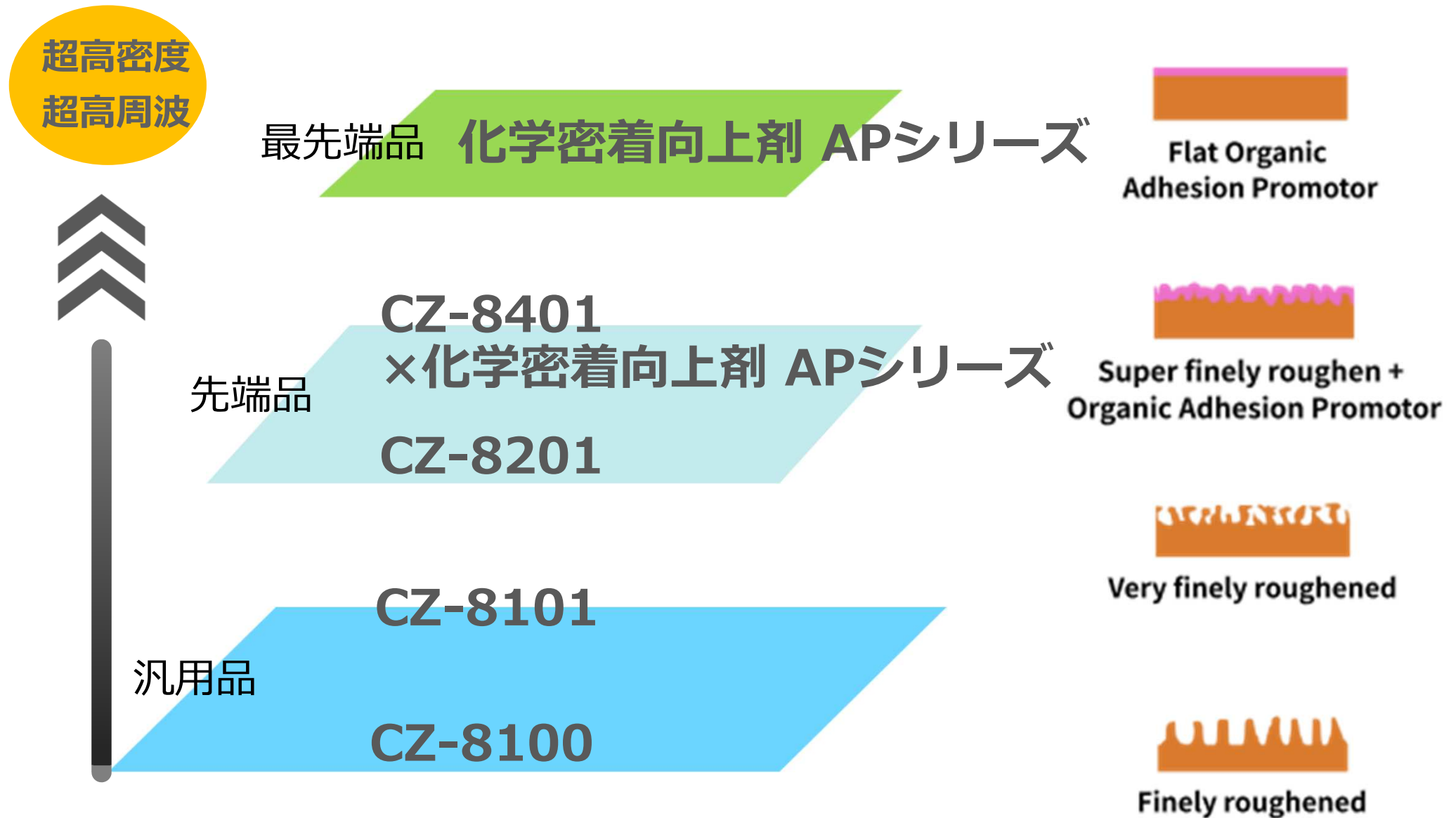
Social

- 人的資本戦略
- 多様な人財の活用（女性活躍、WLB、男性の育休取得推進等）
- 産業発展への貢献（高速通信整備、自動運転、AI、DX、GX等）

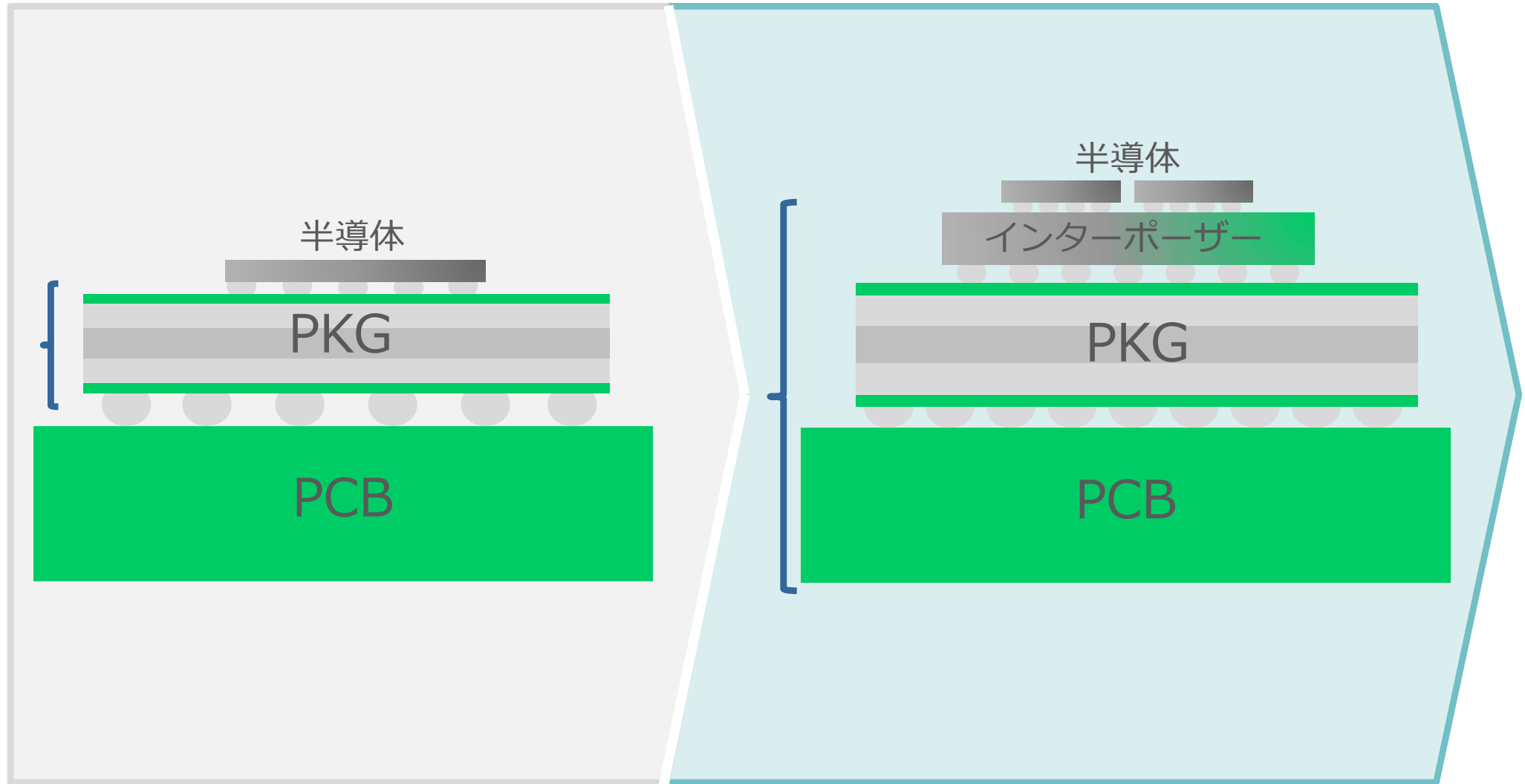
Governance

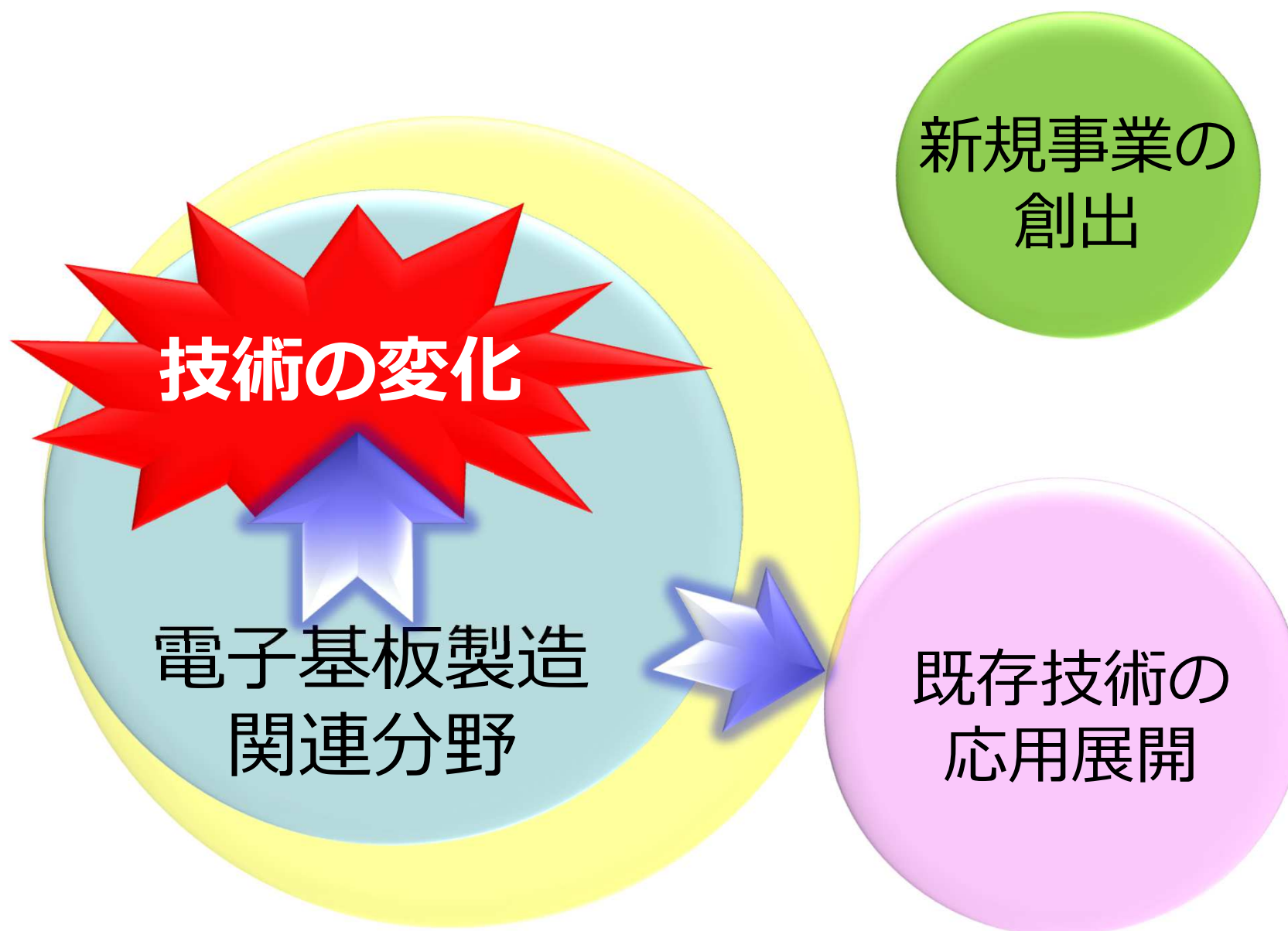
- 経営基盤の強化（CG体制、リスクマネジメント、コンプライアンスの徹底等）

PKG基板の超高密度化、超高周波化



技術領域の拡大を目指して



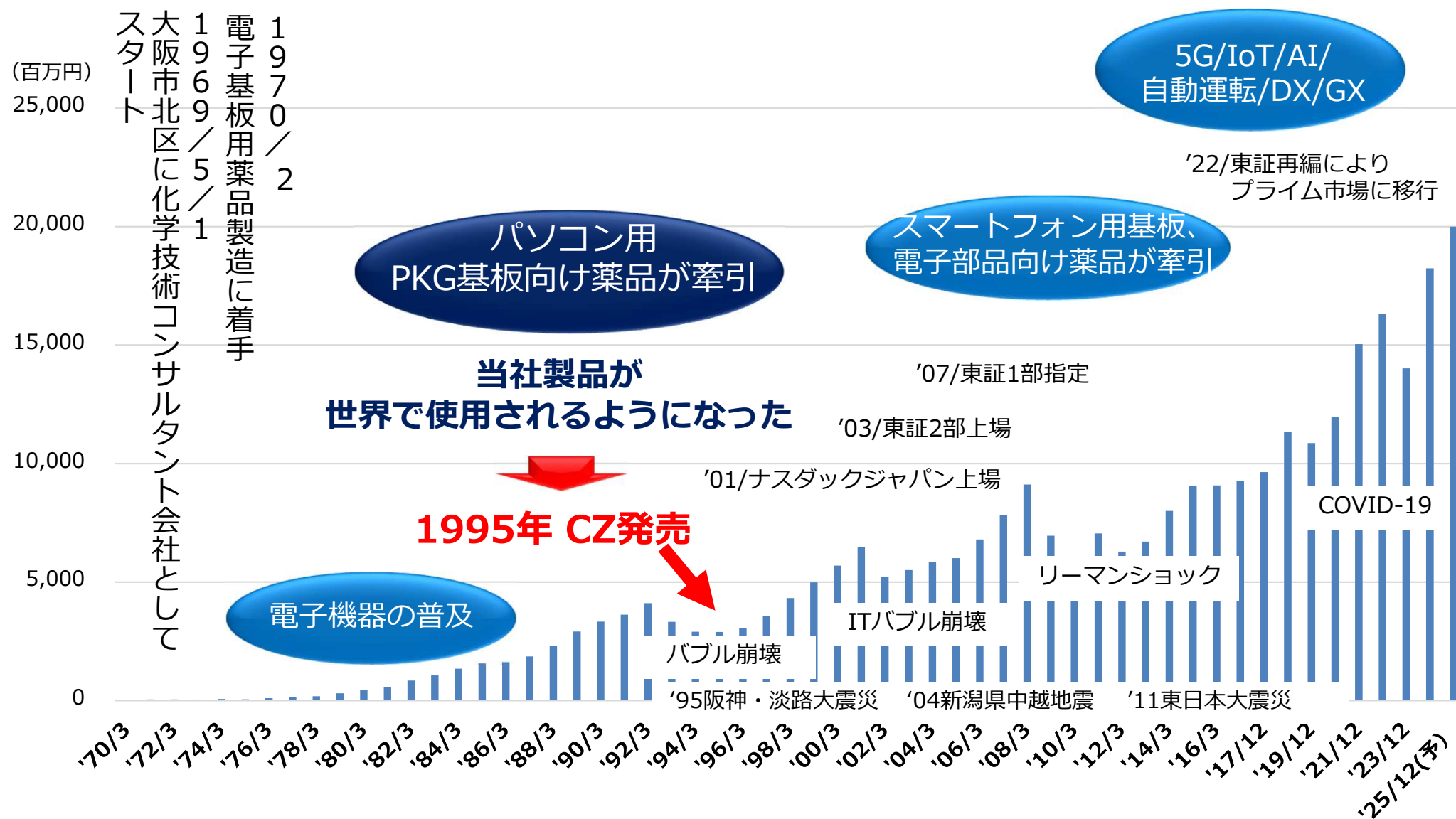


參考資料

(2024年12月31日現在)

社 名	メック株式会社 MEC COMPANY LTD.
本 社 所 在 地	兵庫県尼崎市杭瀬南新町3丁目4番1号
設 立 年 月 日	1969（昭和44）年5月1日
主 な 業 務 内 容	電子基板・部品製造用薬品の開発・製造販売 及び 機械装置、各種資材の販売
代 表 者	代表取締役社長 前田 和夫
資 本 金	5億9,414万2,400円
連 結 売 上 高	182億34百万円
上 場 市 場	東証プライム市場（4971／化学セクター）
従 業 員 数	連結480名、単体277名

創業からの売上推移





研究所から
工場へ



テーマ決定 ⇒ ビーカー実験 ⇒ スケールアップ実験 ⇒ 応用ライン検証



製造 ⇒ 品質検査 ⇒ 充填

お客様へ



当社製品の使用工程例

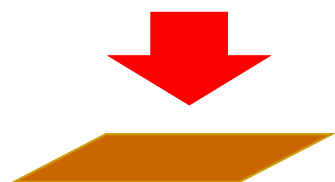
≪乾燥処理≫



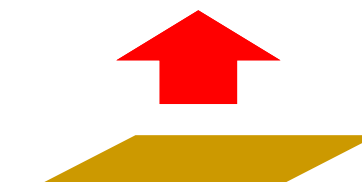
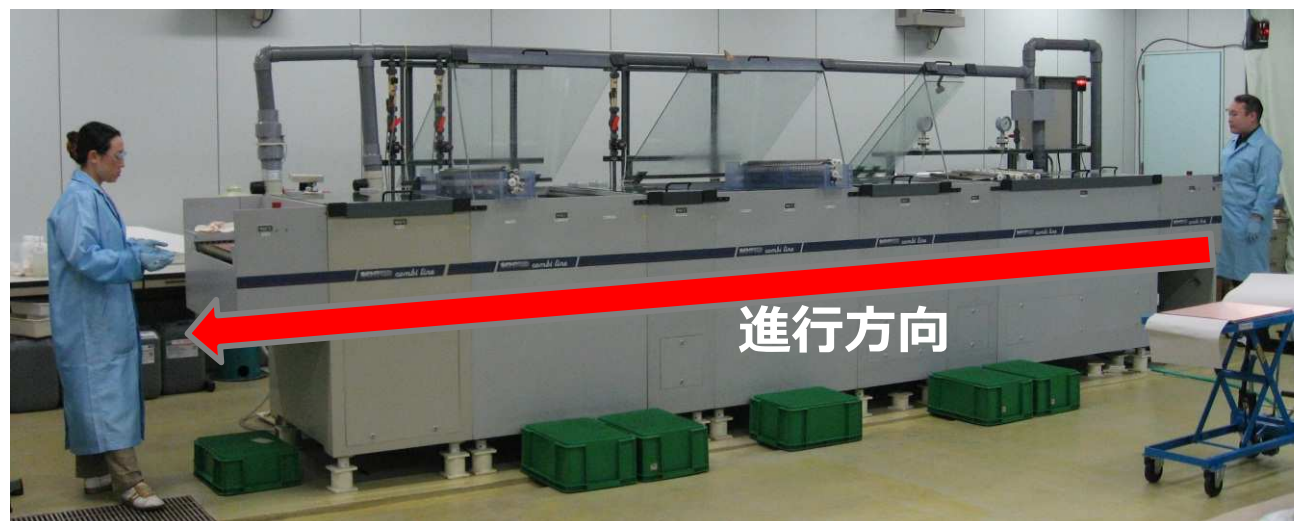
≪水洗処理≫



≪薬液処理≫



基板受取

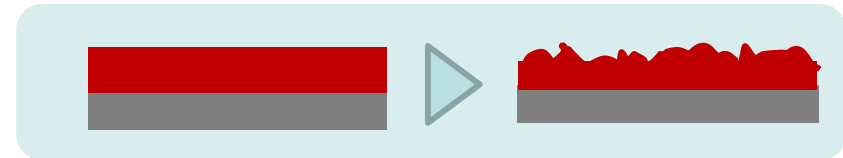


基板投入

界面価値創造

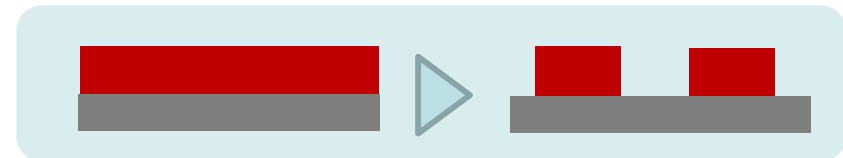
- 表面を粗化し、
機械的に密着性を向上

CZ、V-Bond



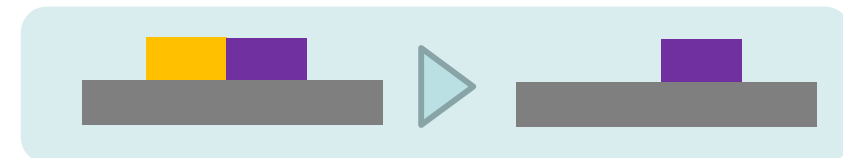
- 配線を形成する

EXE

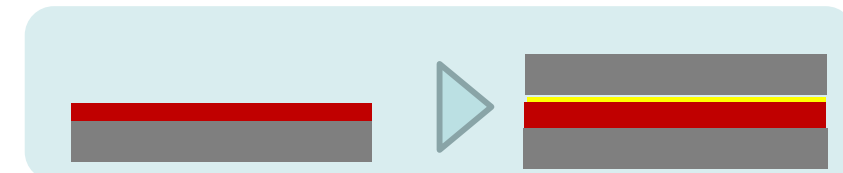


- 選択エッチング

SF



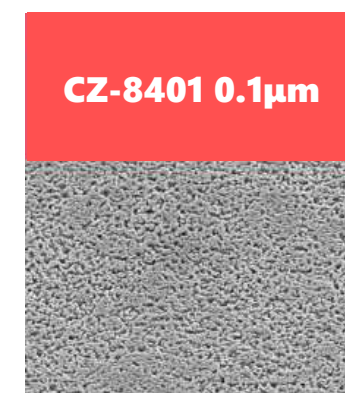
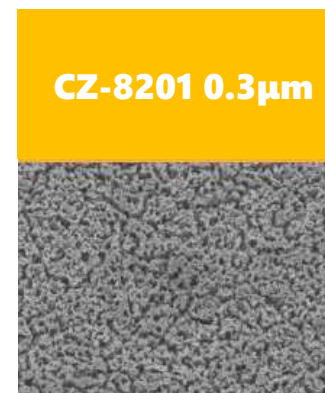
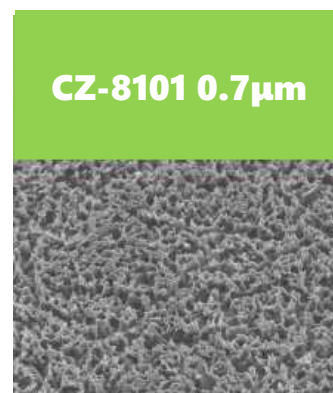
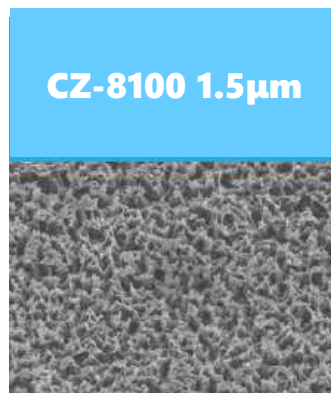
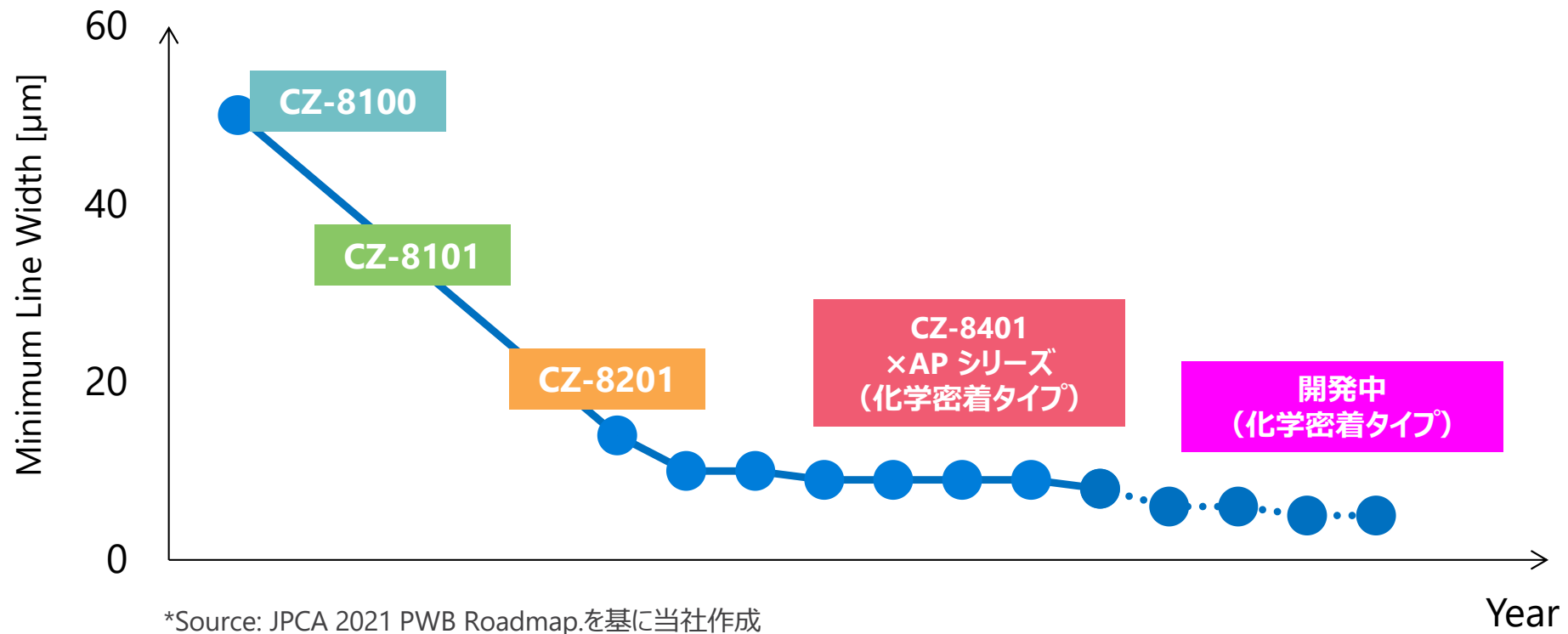
- 表面を処理し、
化学的に密着性を向上



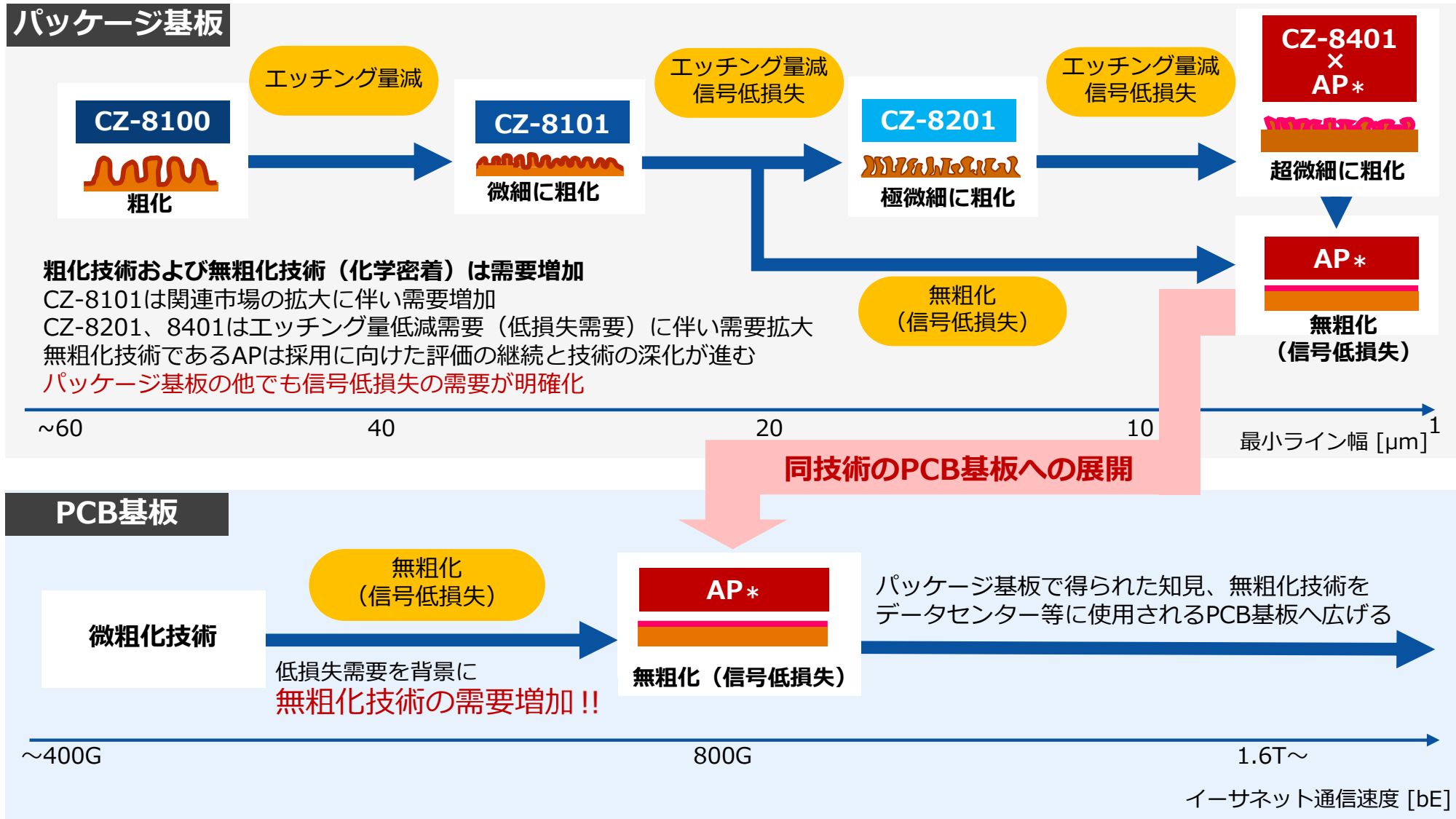
主要薬品用途と最終製品例

主要薬品	特徴	最終製品例
超粗化系密着向上剤 「CZシリーズ」	銅と樹脂との密着性を高める 銅表面処理剤。 主にPKG基板向けの密着向上剤で、 高密度PCBにも使用される。	生成AI関連、5G/6G関連・ データセンター等のインフ ラ、パソコン・スマート フォン・タブレットPC等の 高機能デバイス等
多層電子基板向け密着向上剤 「V-Bondシリーズ」	銅と樹脂との密着性を高める 銅表面処理剤。 多層基板向けの密着向上剤で、 PKG基板には使用されない。	クルマ、スマートフォン、 衛星通信等
異方性エッチング 「EXEシリーズ」	サブトラで微細配線形成ができる。 主にCOF基板向けのエッチング剤 として使用される。	テレビ・パソコンの モニター等
選択エッチング銅除去剤 「SFシリーズ」	銅への選択性を持ったエッチング剤。	タブレットPC等

CZシリーズのロードマップ

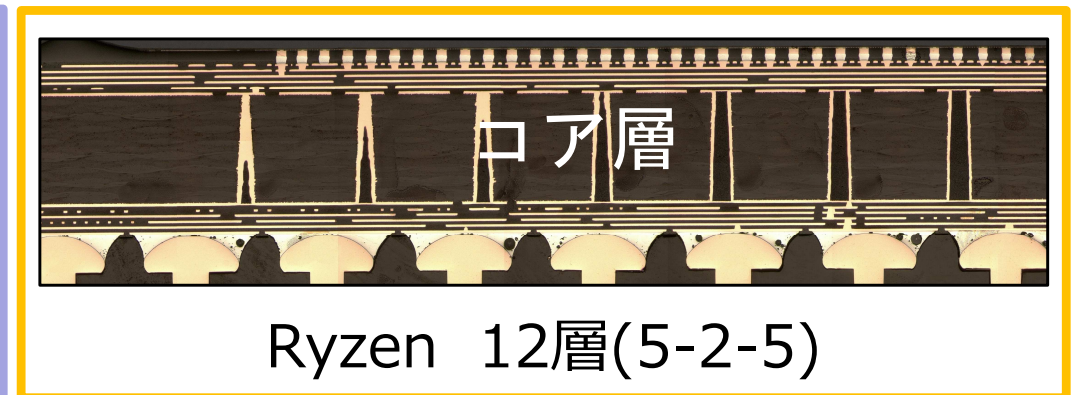
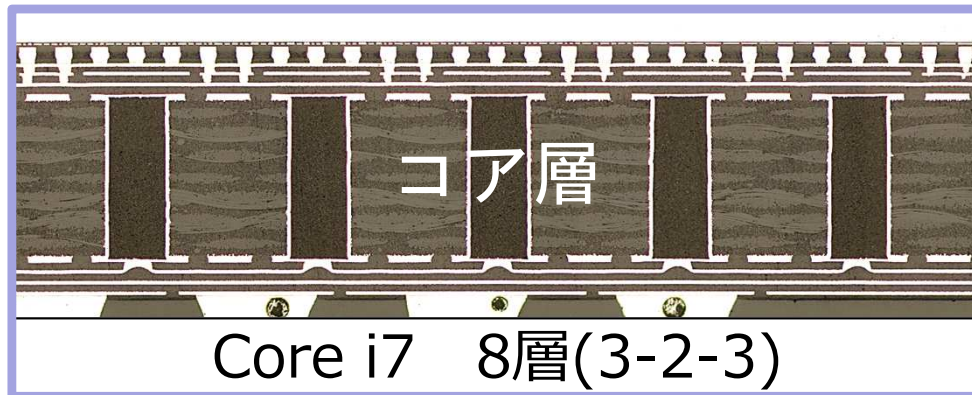
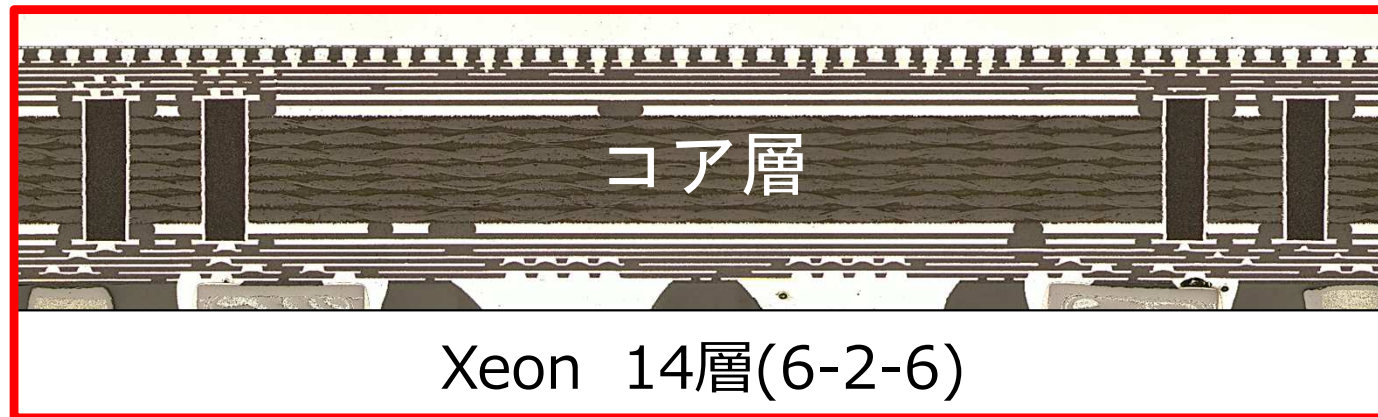


銅表面密着技術の変遷



* AP : Adhesion Promotor 無粗化技術による化学密着、微粗化に対する化学密着補強

PKG基板の断面

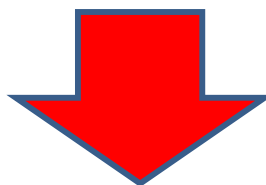
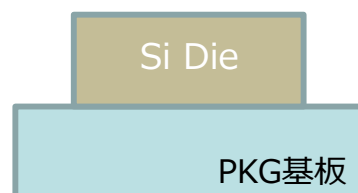


	PKG面積	層数
Xeon	27.44 cm ²	14
Core i7	14.44 cm ²	8
Ryzen	16.00 cm ²	12

*当社で入手、分解しました

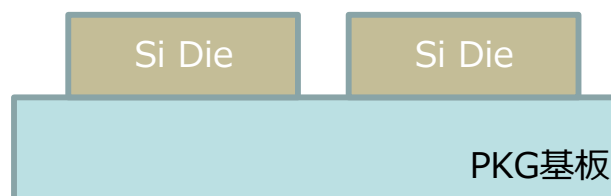
通常のPKG

一つの**PKG**に
一つの半導体



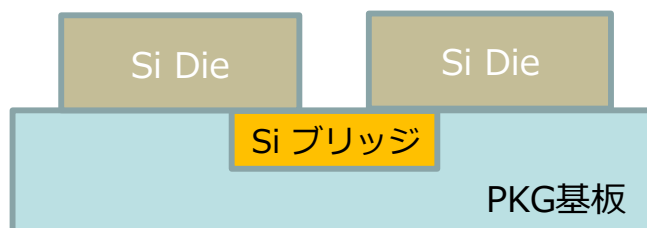
Chiplet

PKGを大きくし
複数の半導体を搭載



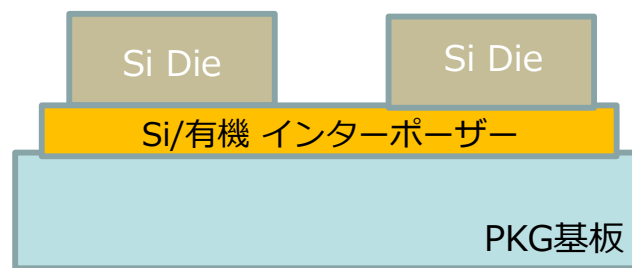
EMIB

(Embedded **M**ulti-die **I**nterconnect **B**ridge)



CoWoS

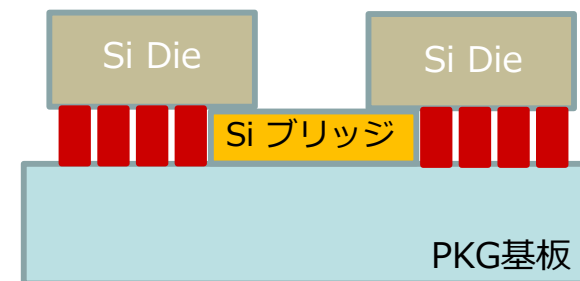
(**C**hip **o**n **W**afer **o**n **S**ubstrate)



EFB

■ 銅ピラー

(Elevated **F**anout **B**ridge)



PKG基板 ⇒ サイズ大型化、層数増加

メックグループ生産能力



尼崎工場（少量多品種）
900 t /月



長岡工場（量産工場）
2,750 t /月

新拠点



北九州工場（仮称）
最大生産能力 2,500 t /月（予定）
2026年12月稼働（予定）



メック台湾
1,200 t /月



メック中国（蘇州）
1,350 t /月



メック珠海
1,000 t /月



メックヨーロッパ
400 t /月



メックタイ
500 t /月

2024年12月現在

2024年12月末現在：8,100t/月（97,200 t /年）前期比12.5% 増強 * 除く北九州工場

界面価値創造

Creating and Fostering Value at Various Interfaces

このプレゼンテーション資料には、2025年5月12日現在の将来に関する予測が含まれております。記述している将来予測および業績予測は、当社が現時点で入手できる情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知ください。

